6.8 RAM 与寄存器堆实验

1. 实验介绍

在本次实验中, 我们将使用 Verilog HDL 语言实现 RAM 以及寄存器堆的设计和仿真。

2. 实验目标

- 深入了解 RAM 与寄存器堆的原理。
- 用 Logisim 画出一个包含 16 个寄存器的寄存器堆原理图。
- 学习使用 Verilog HDL 语言设计实现 RAM 以及寄存器堆。

3. 实验原理

1) RAM

半导体随机读写存储器,简称 RAM,它是数字计算机和其他数字系统的重要存储部件,可存放大量的数据。图 6.25 所示为 RAM 的逻辑结构图,其主体是存储矩阵,另有地址译码器和读写控制电路两大部分。读写控制电路中加有片选控制和输入输出缓冲器等,以便组成双向 I/O 数据线。

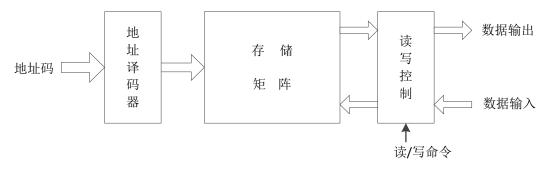


图 6.25 RAM 的逻辑结构图

RAM 有三组信号线:

- 地址线: 单向, 传送地址码(二进制数), 以便按地址码访问存储单元;
- 数据线:双向,将数据码(二进制数)送入存储矩阵或从存储矩阵读出;
- 读/写命令线: 单向控制线, 分时发送这两个命令, 要保证读时不写, 写时不读。 如图 6.26 所示, 为本实验所需要实现的 RAM 的示意图。

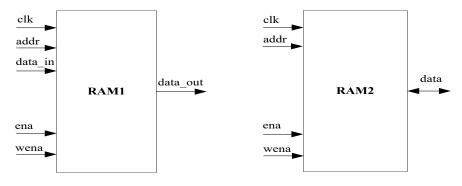


图 6.26 本实验的 RAM 示意图

● 接口定义:

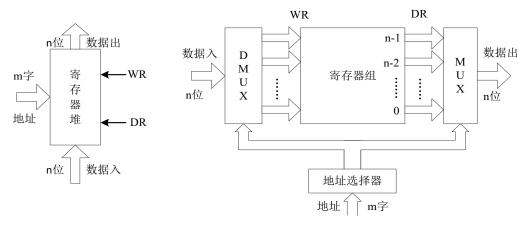
```
module ram (
input clk, //存储器时钟信号, 上升沿时向 ram 内部写入数据
inputena, //存储器有效信号, 高电平时存储器才运行, 否则输出 z
input wena, //存储器读写有效信号, 高电平为写有效, 低电平为读有效, 与 ena
同时有效时才可对存储器进行读写
input [4:0] addr, //输入地址, 指定数据读写的地址
input [31:0] data_in, //存储器写入的数据, 在 clk 上升沿时被写入
output [31:0] data_out //存储器读出的数据
)
```

提示:可以使用 reg 数组来实现,大小至少 1024bit。 测试时可以利用\$readmemh("文件名",数组名)语句使用文件初始化 reg 数组。

2) 寄存器堆 (regfiles)

一个寄存器是由 n 个触发器或锁存器按并行方式输入且并行方式输出连接而成。它只能记忆 1 个字,1 个字的长度等于 n 个比特。当需要记忆多个字时,一个寄存器就不够用了,在这种情况下,需要使用由多个寄存器组的寄存器堆。

图 6.27 为寄存器堆的逻辑结构与原理示意图,它由寄存器组、地址译码器、多路选择器 MUX 及多路分配器 DMUX 等部分组成。向寄存器写数据或读数据,必须先给出寄存器的地址编号。写数据时,控制信号 WR 有效,待写入的数据经 DMUX 送到地址给定的某个寄存器。读数据时,控制信号 RD 有效,由地址给定的某个寄存器的数据内容经多路开关 MUX 送出。由于读/写工作是分时进行的,所以寄存器组在逻辑上能满足写数据或读数据的需要。



(a) 逻辑结构图 (b) 原理示意图 图 6.27 寄存器堆的逻辑结构

图 6.28 给出了由四个 4 位寄存器组成的具有两个数据输出端口的寄存器堆原理图,它可以同时从寄存器堆中取出两个数据,和加法器一起构成一个简单的运算通路。其主要由 1 个 2-4 译码器(ENB 为使能端, S_1 、 S_2 为两位编码输入端, D_1 ~ D_4 为译码输出端)、4 个 4 位寄存器(ENB 为使能端,A~D 为数据输入端, Q_1 ~ Q_4 为数据输出端)和 2 个 4 位 4 选 1 数据选择器(ENB 为使能端, S_1 ~ S_4 为 4 路数据输入端, C_1 、 C_2 为选择控制端,D 为数据输出端)组成。读数据时,读写控制信号 we 为低电平,由地址 raddr1 和 raddr2 指定的两个寄存器的数据分别送到 rdata1 和 rdata2。写数据时,待存入的数据放到输入端 wdata,并给出写的地址 waddr,当读写控制信号 we 为高电平时,waddr 指定的寄存器在时钟上升沿将数据写入到该寄存器。

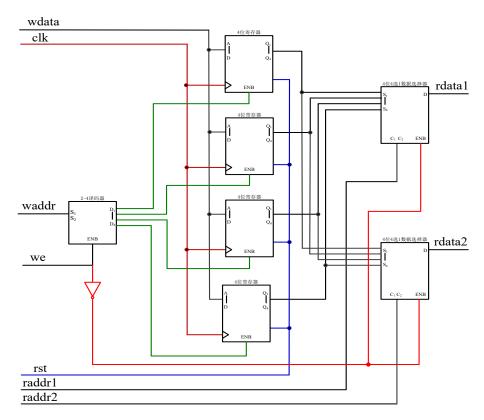


图 6.28 由 4 个寄存器组成的寄存器堆原理图

本实验所要建模的寄存器堆如图 6.29 所示,

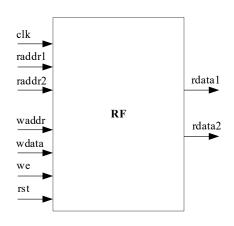


图 6.29 本实验所要建模的寄存器堆功能框图

● 接口定义:

注:要求使用以前实验中的译码器、寄存器、以及选择器的模块实例化来实现。

4.实验步骤

- 1. 参考图 6.8.4, 用 logisim 画出由 16 个 4 位寄存器组成的寄存器堆电路原理图, 并验证逻辑。
- 2.新建 Vivado 工程,编写各个模块。
- 3.用 ModelSim 仿真测试各模块。
- 4. 按照要求书写实验报告。